【力士科技(4923)2024 年前三季營運摘要暨 10 月營收公告新聞稿】　　發佈日期：2024 年 11 月 5 日

力士前三季每股稅後淨損 1.69 元 前 10 月營收 6.84 億元

庫藏股提前執行完畢 預計將轉讓員工、留任人才

專業 MOSFET 設計廠商力士科技（以下簡稱"力士"，台灣櫃買中心股票代碼：4923）公告 2024 年前三季營運摘要暨 10 月營收。

重點摘要：

- 2024 前三季合併營收為新台幣 6.19 億元，營業淨損 89,335 仟元，稅後淨損 56,228 仟元，每股稅後虧損 1.69 元。
- 第三季毛利率 21%，主要係因出售長天期/呆滯庫存所致，第四季將回到正常水位。
- 新布局產品進入正式量產前最後風險測試階段，推升單季研發費用，致費用率拉高，預計在 2025 年上半年正式出貨挹注。
- 10 月合併營收新台幣 6,510 萬元，累計前 10 月 6.84 億元，年增 14.5%。
- 力士日前實施第二次庫藏股，已於 10 月 4 日執行完畢，本次總計買回 600 張、均價 39.29 元，規劃將轉讓予員工、留任績優人才，激勵集團士氣。
- 未來將持續以自有專利 ETG、RTG 技術，擴大耕耘產品應用領域，隨著客戶共同開發 AI 邊緣裝置，以及非 NB/PC 之市場佈局，推升力士產品提供更多元完善解決方案。

營運回顧與展望：

力士於今日董事會公告前三季營運成果，2024 前三季合併營收為新台幣 6.19 億元，受到全球景氣與消費電子市場趨於溫和影響，第三季月均出貨穩定維持在 7 仟萬元水平，與去年同期相當無爆發性成長，然而第三季因出售長天期/呆滯庫存，使毛利率下滑至 21%，預計第四季可回到正常水準；同時，新佈局產品進入量產前最後測試階段，增加研發費用，並持續認列美國訴訟律師費用，致費用率拉高，使營業淨損為 89,335 仟元；業外部分又因今年第三季匯兌損失達 4,592 仟元，造成前三季稅後淨損 56,228 仟元，每股稅後虧損 1.69 元。

公司進一步表示，第三季公司持續投入研發測試費用，主要係因新佈局產品進入量產前最後風險測試階段，新品同樣是採用力士自有專利 RTG 技術生產，預計將用於非 NB/PC 領域之電源供應器，並規劃在 2025 年上半年開始出貨放量，可望挹注力士營運成長動能。

今年前三季以自有專利生產技術 ETG、RTG 比重達 26.06%，穩定向上成長，未來亦將持續投入研發、投入佈局專利，由於未來邊緣 AI 裝置對供電傳輸效能與穩定更趨嚴格，同時又期望裝置體積維持輕薄方便攜帶，而力士之專利生產技術，能有效降低電源供應系統設計成本與占用電路板面積，將 MOSFET 與電源 IC 合併封裝技術，以現有規格乘載超過 45W 以上電流，未來將可望陸續取代現今 45W 規格，升級為力士核心主力 65W-90W 產品，進一步擴大產品市占率。

此外，力士為激勵集團士氣，於 8 月 7 日啟動實施庫藏股，為公司上櫃以來第二次，並於 10 月 4 日提前 100%執行完畢，本次總計買回 600 張、均價 39.29 元，買回總金額為 2,358 萬元，預計將轉讓與員工、留任績優人才。

展望未來，即便消費電子成長動能趨緩、邊緣 AI 略有遞延，然力士仍樂觀趨勢不變，並持續強化自身營運體質，擴大產品應用範疇，同時積極參與客戶開發測試與規格制訂專案，爭取更多產品線供應商資格，目前客戶實際回饋力士提供之各項產品效能優異且穩定，解決方案效果佳，待未來正式放量出貨，可望推升力士營運顯著成長向上。

附表一、力士 2024 年前三季財報比較表　　單位：新台幣仟元/元；%

年度	2024	2023	年增率 YoY
合併營收	619,248	527,464	17.40
營業利益	(89,335)	(8,025)	—
稅後淨利 (母公司業主)	(56,228)	8,172	—
每股稅後盈餘(元)	(1.69)	0.24	—

附表二、力士 2024 年 10 月營收簡表：　　單位：新台幣仟元；%

年度 期間	2024	2023	年增率 YoY
10 月	65,101	70,254	-7.33
1-10 月	684,349	597,708	14.50

新聞聯繫人：

力士科技　發言人/副總經理　鍾秉家
電話：(02)8976-9223
E-mail：ir@force-mos.com

如時公關　媒體公關部　簡夢嫻
電話：(02)2536-1237／0936-392876
E-mail：sandychien@time-ir.com.tw

關於力士：

力士科技（股票代號：4923）成立於 2007 年，為台灣 MOSFET 技術集成電路設計之先驅，公司專注於 MOSFET 之研發、設計和生產，擁有 POWER MOSFETS 最佳設計及製程整合技術團隊，主力產品包括 MOSFET 成品、半成品晶圓片 Wafer 等。產品應用涵蓋 PC/NB、手機、電池、TV 面板等領域，擁有共近百件豐富專利布局，並與專屬晶圓代工廠與封測廠封閉式製程平台滿足客戶高客製化產品需求。

更多資訊請連結公司官網：http://www.force-mos.com

聲明：

本文件及同時發佈之相關資訊內含有預測性敘述。除針對已發生事實，所有對力士科技(以下簡稱本公司)未來經營業務、可能發生之事件及展望（包括但不限於預測、目標、估算和營運計劃）之敘述皆屬預測性敘述。預測性敘述會受不同因素及不確定性的影響，造成與實際情況有相當差異，這些因素包括但不限於價格波動、實際需求、匯率變動、市占率、市場競爭情況，法律、金融及法規架構的

改變、國際經濟暨金融市場情勢、政治風險、成本估計等，及其他本公司控制範圍以外的風險與變數。這些預測性敘述是基於現況的預測和評估，本公司不負日後更新之責